

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-058

债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于扩建潜江CMP软抛光垫生产线的自愿性披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、项目概述

玻璃基板技术（TGV）被广泛认为是替代硅中介层（TSV）的下一代高密度互连技术，其在先进封装、光电共封装（CPO）、高带宽存储器（HBM）等领域拥有广阔应用前景，为把握半导体产业升级、玻璃基板技术迭代、大尺寸衬底等行业机遇，进一步夯实湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）半导体CMP抛光垫主业优势，完善产品布局，提升长期经营价值与综合竞争力，公司旗下湖北鼎汇微电子材料有限公司全资子公司—湖北鼎龙汇盛新材料有限公司，拟于近期启动潜江园区第三条软抛光垫生产线建设项目。本项目重点布局玻璃基板CMP抛光垫与大尺寸（直径大于2米）抛光垫两大高端产品方向，规划年产能30万片，项目总投资3,000万元，预计于2026年年底建成投产。

本项目投资金额未达到提交董事会或股东会审议标准，无需提交董事会或股东会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、项目基本情况

- 1、项目内容：建设第三条软抛光垫生产线，主要生产玻璃基板CMP抛光垫及大尺寸抛光垫。
- 2、实施地点：湖北省潜江市江汉盐化工业园长飞大道1号。
- 3、实施主体：湖北鼎龙汇盛新材料有限公司。
- 4、投资规模：计划投资3,000万元。

- 5、资金来源：公司自有或自筹资金。
- 6、规划产能：年产能 30 万片。
- 7、建设周期：预计于 2026 年年底建成投产，最终以实际开展情况为准。

三、行业背景与项目建设必要性

（一）CMP 抛光垫行业细分产品介绍

CMP（化学机械抛光）抛光垫按照材料特性可分为硬抛光垫和软抛光垫。硬抛光垫的核心材料为热固性聚氨酯树脂，一般采用浇注成型的方式生产，产品硬度较大。硬抛光垫广泛用于晶圆制造各类 CMP 制程，涵盖浅沟槽隔离（STI）、层间介质（ILD）、钨通孔、铜互连等环节的抛光。

本次建设的产线聚焦于软抛光垫，该产品以热塑性聚氨酯树脂为核心材料，主要采用合成革湿法成型工艺生产，产品硬度相对较软。软抛光垫的应用场景丰富，不仅可作为硬抛光垫的缓冲层，还广泛用于晶圆制造各类 CMP 制程的精抛、铜阻挡层（Cu barrier）抛光、晶背减薄、大硅片的粗抛和精抛、碳化硅衬底以及其他化合物半导体衬底材料的抛光。此外，软抛光垫在机械硬盘抛光、玻璃抛光等领域亦有广泛应用。

CMP 软抛光垫作为晶圆、大硅片、玻璃基板等产品制造环节的关键耗材，预计 2026 年国内市场规模超 10 亿元，并将在先进制程、先进封装等工艺发展驱动下，行业有望保持较快增长。当前国内 CMP 软抛光垫供应由海外厂商主导，国产化率低。

（二）现有产能现状及扩产动因

公司软抛光垫产线坐落潜江市江汉盐化工业园，现有两条合成革湿法成型生产线，年产能 50 万片。产线自 2022 年 8 月份投产以来，经过近 4 年发展，产品已覆盖硬抛光垫缓冲层、晶圆 CMP 精抛、铜阻挡层（Cu barrier）抛光、晶背减薄、大硅片粗抛和精抛、碳化硅衬底粗抛和精抛等应用领域。目前产能利用率已经接近 80%。现有产能预计将难以匹配下游市场的快速增长以及新技术趋势带来的新产品需求。

一方面，先进封装技术近年来发展迅猛，**CMP 抛光材料成为影响玻璃基板技术规模化量产的关键配套材料。TGV 玻璃基板技术被业内广泛视作替代硅中**

介层（TSV）的下一代高密度互连技术，具备热匹配性好、互联密度高、高频低损耗等优势。在先进封装、光电共封装（CPO）、高带宽存储器（HBM）等领域拥有广阔应用前景。目前玻璃基板技术已经在部分国际厂商启动初步量产。在玻璃基板技术中，加工形状由圆形转变为方形，且玻璃材质脆性显著高于硅片，这对 CMP 工艺提出全新的挑战，也对 CMP 材料提出了更高的要求。因此，**玻璃基板 CMP 抛光垫的研发及量产，将直接影响到玻璃基板技术规模化落地的进程。**

另一方面，大尺寸半导体衬底成为主流，客户需求旺盛。公司现有的两条软抛光垫生产线设计初衷主要面向晶圆 CMP 相关的应用，受产线幅宽限制，仅能生产直径小于 1.5 米的抛光垫产品。伴随芯片衬底生产工艺的进步，12 英寸大硅片已成主流；8 英寸碳化硅衬底已实现规模化量产，12 英寸碳化硅衬底亦完成研发落地。上述大尺寸衬底的粗抛环节，均需配套大尺寸抛光垫，最大直径超 2 米。

此外，公司位于武汉市经济技术开发区的硬抛光垫生产线，月产能已于 2026 年一季度提升至 5 万片。后续随着硬垫产量提升对缓冲垫需求带动，以及下游客户新产能释放带来的各类需求，公司的 CMP 软抛光垫需求量预计将持续提升。

四、对公司的影响

本次投建第三条软抛光垫生产线，将进一步丰富公司 CMP 抛光垫产品矩阵，全面覆盖衬底制造、晶圆制造和先进封装领域的产业需求，是公司长期深耕半导体材料、坚持自主创新的重要布局，有助于强化公司在半导体材料领域的核心竞争力与市场地位，提升整体盈利水平，推动公司实现新业务领域的突破，同时加速相关产品的国产化进程。

五、风险提示

1、考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。但不会对公司目前经营产生重大影响。

2、公司半导体材料项目的技术、工艺要求和市场门槛极高，虽然公司在研发阶段做了各项充足准备，在产业化的过程中仍会存在一定的实施风险，具体项目的实施及推进仍存在一定的投资风险及不确定性。

公司将根据项目具体进展情况，依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2026年6月9日